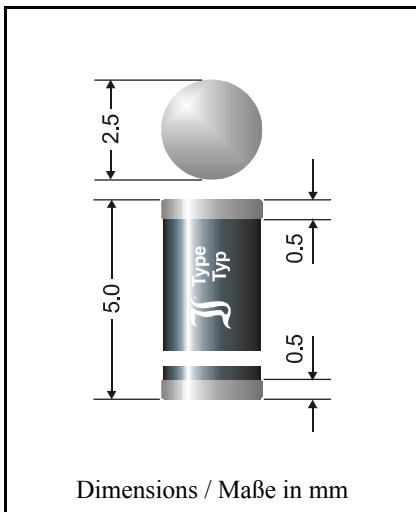


**Surface Mount Schottky-Rectifiers**

**Schottky-Gleichrichter für die Oberflächenmontage**



Nominal current – Nennstrom	2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...100 V
Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF	DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gurgtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Forward voltage Durchlaßspannung $V_F$ [V] <sup>1)</sup>
SMS 220	20	20	< 0.50
SMS 230	30	30	< 0.50
SMS 240	40	40	< 0.50
SMS 250	50	50	< 0.70
SMS 260	60	60	< 0.70
SMS 290	90	90	< 0.79
SMS 2100	100	100	< 0.79

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einweschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	2 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	$I_{FRM}$	12 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	50 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	12,5 A <sup>2</sup> s

<sup>1)</sup>  $I_F = 2\text{ A}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

<sup>2)</sup> Max. temperature of the terminals  $T_T = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Anschlüsse  $T_T = 100^\circ\text{C}$

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  
Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$  – 50...+150°C  
 $T_s$  – 50...+150°C

### Characteristics

### Kennwerte

Leakage current – Sperrstrom

$T_j = 25^\circ\text{C}$   
 $T_j = 100^\circ\text{C}$

$V_R = V_{RRM}$   
 $V_R = V_{RRM}$

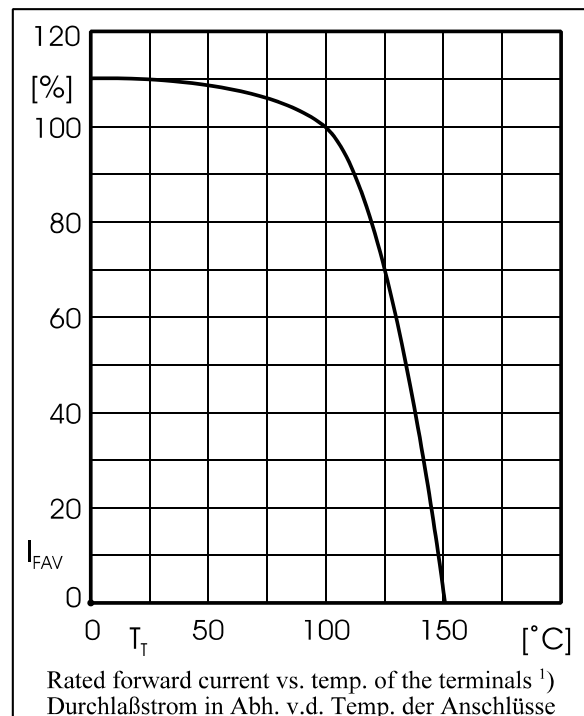
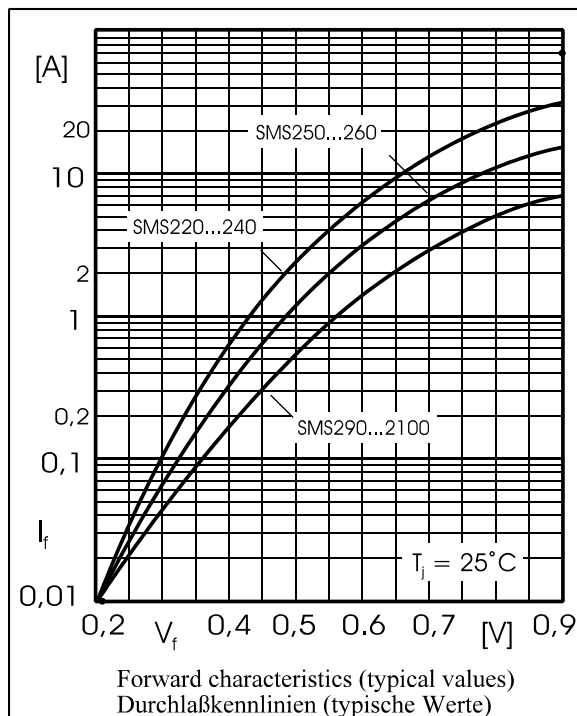
$I_R < 0.5\text{ mA}$   
 $I_R < 10.0\text{ mA}$

Thermal resistance junction to ambient air  
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

$R_{thA} < 45\text{ K/W}^1)$

Thermal resistance junction to terminal  
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

$R_{thT} < 10\text{ K/W}$



<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 50 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß